

## ЕРА- М2СТІ Теплоотводящая алюминиевая основа

### Особенности

Соответствие требованиям ROHS и требованиям REACH.

Обладает более высокой теплопроводностью, чем обычный FR-4, что способствует эффективному увеличению срока службы электронных приборов.

Вместо стекловолокна в слое диэлектрика использована керамическая крошка.

Хорошие механические свойства.

Отличная стабильность размеров.

Электромагнитное экранирование.

### Область применения:

Основа устройств электрических машин, Светодиодная подсветка, Внутреннее/Внешнее освещение, Уличное LED освещение, LED подсветка сцены, преобразовательная техника.

Другое: Подложка для чипов микросхем.

**Сплавы** : 1060#, 1100#, 3003#, 5052#, 6161#

**Толщина материала**: 0.6мм ; 0.8мм ; 1.0мм ; 1.2мм ; 1.5мм ; 2.0мм ; 3.0мм.

**Медная фольга** : 1OZ ; 2OZ ; 3OZ ; 4OZ.

**Доступные размеры** : 500×600мм ; 600×1000мм ; 500×1200мм.

### Параметры

Наименование	Соответствие требованиям	Ед. измерения	Показатель	
Толщина изоляции	IPC-TM-650 2.2.18.1	μм	100	150
Тепловой стресс	IPC-TM-650 2.4.13.1	с	288°C>120с	288°C>120с
Прочность на отрыв	IPC-TM-650 2.4.8.1	Н/мм	1.2	1.2
Предельное напряжение	IPC-TM-650 2.5.6	кВ(DC)	3.0	5.0
Напряжение пробоя	IPC-TM-650 2.5.6	кВ(AC)	4.0	6.0
напряжение пробоя по поверхности печатной платы	IEC60112	В	>600	>600
Температура стеклования	IPC-TM-650 2.4.25	°C	140	140
коэффициент теплового расширения	IPC-TM-650 2.4.24	% (50~260°C)	0.50	0.50
Поверхностное сопротивление	IPC-TM-650 2.5.17.1	Ω	3.96×10 <sup>9</sup>	3.96×10 <sup>9</sup>
Объемное сопротивление	IPC-TM-650 2.5.17.1	Ω·см	1.68×10 <sup>11</sup>	1.68×10 <sup>11</sup>
Сопротивление изоляции	JIS6481-1996	Ω	1.46×10 <sup>11</sup>	1.46×10 <sup>11</sup>
Диэлектрическая постоянная 1МГц	IPC-TM-650 2.5.5.9	/	≤5.6	≤5.6
Коэффициент рассеяния 1МНЗ	IPC-TM-650 2.5.5.9	/	≤0.034	≤0.034
Водопоглощение	IPC-TM-650 2.6.2.1	%	<0.5	<0.5
Теплопроводность	ASTM D 5470	Вт/м·К	2.0	2.0
Тепловое сопротивление	/	°C/Вт	0.45	0.53
Воспламеняемость	UL94	/	V-0	V-0